

## 《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》赞助征集办法

由中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会基板材料分会、国家电子电路基材工程技术研究中心共同举办的《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》，拟定于**2017年11月8日-10日**在“**东莞市尼罗河酒店**”召开。鉴于每届研讨会都有众多企业积极利用这一有效平台进行宣传，为会议提供赞助。为了回报赞助单位对协会工作的支持，现对赞助与服务有关事项说明如下：

### 一、赞助与服务

#### 赞助额在**5000元及10000元以上**

- ① 在会议室主席台上布置的大型彩色喷绘背景图、会议代表证、会议邀请书、协会网站、协会资讯上作为赞助单位出现；
- ② 将赞助方的宣传资料分装在每个代表的资料袋中；
- ③ 将赞助方的商务宣传报告收录在《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会报告论文集》中（以下简称《论文集》）；
- ④ 在会前及会议休息期间播放赞助企业介绍 PPT（由公司自行设计 PPT 一页）；
- ⑤ 赞助单位易拉宝展示（由公司自愿自行设计制作，尺寸为：80cm(宽)\*200cm(高)）；
- ⑥ 按赞助额大小，赞助单位的彩色广告（广告内容由公司提供，必须真实可靠，由此引发的纠纷一律由公司负责）依次收集在《论文集》里；
- ⑦ 赞助额最大者，作为协办单位出现；安排公司领导在开幕式主席台就座并致辞。

注：资讯宣传：会议结束后在资讯上用彩色刊印赞助单位名片，内容包括单位名称、徽标、地址、电话、传真、网址、Email 等。

### 二、相关事项：

1、凡有意向提供赞助的单位，请填写回执表，用传真或电子邮件发回协会秘书处，并将赞助费用同时通过银行汇至协会账户。在《论文集》中所收集的宣传资料，请于**10月25日前**用电子邮件发回协会秘书处。

#### 2、会议赞助通信联络：

联系人：王晓艳            13609146084

电 话：029-33335234

传 真：029-33335234

E-mail: ccla33335234@163.com

网 址: www.chinaccl.cn

3、汇款事项:

银行汇款: 帐 户: 中国电子材料行业协会

开户银行: 工行北京香河园支行

账 号: 0200 0191 0900 0125 724

中国电子材料行业协会覆铜板分会秘书处  
《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》组委会

2017年8月7日

---

《第十八届中国覆铜板技术·市场研讨会》赞助单位回执

赞助单位(签章):

2017年 月 日

联系人		手机	
E-mail		广告资料 发出日期	
赞助金额 (元、大写)		汇出日期	
备注	开票信息: 名 称: 纳税人识别号: 地 址、电 话: 开户行及账号:		